JEITA Japan Electronics & Information Technology Industries Association

JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会2014

（旧 鉛フリー化活動 成果報告会）

日 時　平成26年7月10日(木) 10:00～17:00 (受付開始 9:30～)
場 所　芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室
主 催　一般社団法人 電子情報技術産業協会
企 画　JEITA／実装技術標準化専門委員会

Program

司 会　山本 克己 氏　テクノオフィス・ヤマモト

10:00～10:05	**主催者挨拶** 岡本 正英　JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 ((株)日立製作所)
10:05～10:10	**来賓挨拶** 西尾 直美 氏　経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 電子デバイス一係長
10:10～10:40	**実装領域における3Dモデル活用と標準化活動について** 村田 貴昭 氏　ソニー(株)
10:40～11:10	**JEITA ET-7501-1「ランドパターン設計に関わる表面実装部品外形図の作成指針」制定の経緯と今後の取り組み** 石橋 広行 氏　オムロン(株)
11:10～11:40	**電子部品のMSLによる分類と包装に関する国際規格化の取り組み** 反保 昌博 氏　(株)村田製作所
11:40～12:10	**EU-ELV指令の動向（はんだの適用除外規定見直しについて）** 加藤 克久 氏　(株)デンソー
	休　憩　（昼食は各自にてお願いいたします）
13:10～13:30	**METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」の取り組み状況** 春日 壽夫 氏　基準認証イノベーション技術研究組合 (IS-INOTEK)
13:30～14:00	**部品内蔵基板対応CAD/CAM技術と設計データフォーマットの標準化** 松澤 浩彦 氏　(株)図研
14:00～14:30	**フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC及びJIS規格化状況** 西川 宏 氏　大阪大学 接合科学研究所 スマートプロセス研究センター 准教授
14:30～14:45	**JEITAでの高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組みについて** 芹沢 弘二 氏　(高温鉛入りはんだ代替金属材料WG 主査)
	休　憩
15:00～15:30	**高温鉛入りはんだ代替材料のダイボンドへの適用可能性** 上島 稔 氏　千住金属工業(株)
15:30～16:00	**JEITA第2世代低銀系ソルダペースト標準品の特性** 小笠原 毅 氏　ニホンハンダ(株)
16:00～16:30	**SAC系はんだ接合寿命予測に関する苅谷モデルの実証実験(その2)** 山本 剛 氏　富士通アドバンストテクノロジ(株)
16:30～17:00	**SAC系はんだ合金の疲労き裂進展メカニズム** 苅谷 義治 氏　芝浦工業大学 工学部 材料工学科 教授

プログラムの内容につきましては、都合により変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

JEITA

環境調和型先端実装技術　成果報告会2014

ご 挨 拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年から実装技術の鉛フリー化活動に取り組んで参りました。またこれらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会』として、この一年間の環境に優しい先端的な実装技術の検討結果および鉛フリー化関連活動成果を、ご報告させていただきます。

今回は、プリント基板のパッド・ランドパターン設計、電子部品の吸湿感度レベル、METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」をはじめ、鉛フリー化関連では、昨年完了したMETIプロジェクト『フロー槽材料の長期信頼性に関わる各種特性の評価試験方法に関する標準化』を基にしたフロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法の標準化状況、同じく昨年完了したJEITAプロジェクト『第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペーストの標準化』の結果を受けた第2世代低銀系ソルダペースト標準品の市場動向、ELV指令改定の動向等、多岐に亘るテーマについて、ご報告させていただきます。

他にも、高温鉛入りはんだの鉛フリー化、現在主流になっている錫-銀-銅系鉛フリーはんだの接合寿命予測等、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動の成果についてもご報告致します。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA　実装技術標準化専門委員会　委員長　岡本 正英（(株)日立製作所）

参加要領

■日　　時　平成２６年７月１０日（木）１０：００～１７：００（受付開始9:30～）

■場　　所　芝浦工業大学　豊洲キャンパス交流棟（６階）　大講義室
東京都江東区豊洲3-7-5
http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html

■申 込 方 法　参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込み下さい。登録完了時には、登録E-Mailアドレスに確認メールをお送り致します。
また、ご登録のご住所宛に「受講票」と「請求書」をお送り致します。
申込書は以下リンクよりダウンロードください。
http://home.jeita.or.jp/tss/2014kankyochowa_EntrySheet.xls
（本状下部の申込書に記入いただき、FAX送信いただいても結構です。）

■申 込 期 限　平成２６年７月４日（金）必着

■定　　員　１５０名（定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込み下さい。）

■参　加　費　１０，０００円(会員会社)　　１５，０００円（非会員会社）
※　JEITA会員になることをご検討中の非会員会社につきましては、今回は会員扱いとさせて頂きます。後日担当部門から入会手続きのご連絡をさせて頂きます。

■配 布 資 料　成果報告書（当日配布）

■お問合せ先　一般社団法人 電子情報技術産業協会　知的基盤部 標準Ｇ（岩渕・澤田）
TEL:03-5218-1059　FAX:03-5218-1078
E-mail:tsc4@jeita.or.jp

会場へのアクセス

最寄駅のご案内：東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩7分、又はJR京葉線「越中島駅」2番出口より徒歩15分

（一社）電子情報技術産業協会／知的基盤部行
FAX:03-5218-1078　E-mail:tsc4@jeita.or.jp

「環境調和型先端実装技術　成果報告会2014」参加申込書

貴　社　名		会 員 確 認	会員 ・ 非会員（いずれかに○を付けて下さい。）

※　会員／非会員の確認は、JEITA会員一覧＜http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi ＞でお願いします。

参加者氏名		所属役職名	
連絡先住所	（〒　　）		
ＴＥＬ番号		ＦＡＸ番号	
Ｅ－ｍａｉｌ			

※　複数名の参加申込みの場合は、下記にお書き下さい。（受講票と請求書は参加者毎に別々にお送りします。）

参加者氏名		所属役職名	
連絡先住所	（〒　　）		
ＴＥＬ番号		ＦＡＸ番号	
Ｅ－ｍａｉｌ			